

各 位



平成 29 年 4 月 7 日

会社名 TDK株式会社
代表者 代表取締役社長 石黒 成直
(コード番号 6762 東証第1部)
問合せ先責任者 広報グループゼネラルマネージャー
熱海 一成
(TEL 03-6852-7102)

(開示事項の経過) Qualcomm との業務提携ならびに 合弁会社の設立に関するお知らせ

平成 28 年 1 月 13 日付「Qualcomm との業務提携ならびに合弁会社の設立に関するお知らせ」及び平成 29 年 2 月 3 日付「(開示事項の経過) Qualcomm との業務提携ならびに合弁会社の設立に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社は、高周波フロントエンド (RF FE) モジュールや RF フィルタの提供を行う合弁会社 RF360 Holdings Singapore PTE. Ltd. への事業移管を平成 29 年 2 月 3 日に実行いたしました。このたび、合弁会社の概要のうち、算定中としておりました「資本金」、「純資産」及び「総資産」につきまして、それぞれの額が確定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、今般確定した事項については、当該事項に下線を付しております。

合弁会社の概要

(1) 名 称	RF360 Holdings Singapore PTE. Ltd.
(2) 所 在 地	シンガポール
(3) 代表者の役職・氏名	Duane Nelles III
(4) 事 業 内 容	高周波モジュール、高周波部品の開発、設計、調達、製造、販売等
(5) 資 本 金	<u>2,634,455 千米ドル</u>
(6) 設 立 年 月 日	2016 年 3 月 1 日
(7) 決 算 期	9 月 30 日
(8) 純 資 産	<u>2,634,499 千米ドル</u>
(9) 総 資 産	<u>2,694,289 千米ドル</u>
(10) 出 資 比 率	Qualcomm Global Trading PTE. Ltd. : 51%、EPCOS AG : 49%

以 上